



Title of Change:	QRE1113GR Series Encapsulation Resin Change.									
Proposed First Ship date:	19 May 2020 or earlier if approved by customer									
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <kenny.chan@onsemi.com>									
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com>. Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.									
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <ChangKit.Mok@onsemi.com>									
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com									
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Lot with new encapsulation resin will be with datecode work week 04 year 2020 or later.									
Change Category:	Assembly Change									
Change Sub-Category(s):	Material Change									
Sites Affected:										
ON Semiconductor Sites			External Foundry/Subcon Sites							
None			Subcon, Taiwan							
Description and Purpose:										
Due to supplier discontinuing encapsulation resin production, product is qualified to using new encapsulation resin WG8606.										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Before Change Description</th> <th>After Change Description</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Encapsulation Resin</td> <td>DP5563</td> <td>WG8606</td> </tr> </tbody> </table>						Before Change Description	After Change Description	Encapsulation Resin	DP5563	WG8606
	Before Change Description	After Change Description								
Encapsulation Resin	DP5563	WG8606								
There is no product marking change as a result of this change.										
Reliability Data Summary:										
QV DEVICE NAME : QRE1113GR										
RMS# : 190711										
PACKAGE : REFLECTIVE RECTANGULAR SURFACE MOUNT										
Test	Specification	Condition	Interval	Results						
HTOL	JESD22-A108	Ta=85°C, biased	1008 hrs	0/231						
LTOL	JESD22-A108	Ta= -40°C, biased	1008 hrs	0/66						
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +100°C	300 cyc	0/66						
THB + PC	JESD22-A101	Ta=85°C / 85% RH, biased	1008 hrs	0/66						
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 260°C	-	0/132						
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-	0/66						



Electrical Characteristics Summary:

Electrical characteristics are not impacted.

List of Affected Part:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the **PCN Customized Portal**.

Part Number	Qualification Vehicle
QRE1113GR	QRE1113GR

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23072X

発行日: 12 Feb 2020

変更件名:	QRE1113GR シリーズのカプセル化樹脂の変更。
初回出荷予定日:	19 May 2020 またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前。
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <kenny.chan@onsemi.com> にお問い合わせください。
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.Samples@onsemi.com> にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。
追加の信頼性データ:	お客様の地域のオン・セミコンダクター営業所または <ChangKit.Mok@onsemi.com> にお問い合わせください。
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> 宛てにお願いします。
変更部品の識別:	新しいカプセル化樹脂を使用したロットは、2020 年以降の日付コード作業週 04 になります。

変更カテゴリ: アセンブリの変更

変更サブカテゴリ: 材料の変更

影響を受ける拠点:

オン・セミコンダクター拠点:

外部製造工場 / 下請業者拠点:

無し

Subcon, Taiwan

説明および目的:

サプライヤーは封止樹脂の生産を中止しているため、製品は新しい封止樹脂 WG8606 を使用する資格があります。

	変更前の表記	変更後の表記
カプセル化樹脂	DP5563	WG8606

この変更の結果としての製品マーキングの変更はありません。

信頼性データの要約:

デバイス名 : QRE1113GR

RMS : 190711

パッケージ : REFLECTIVE RECTANGULAR SURFACE MOUNT

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTOL	JESD22-A108	Ta=85°C, biased	1008 hrs	0/231
LTOL	JESD22-A108	Ta= -40°C, biased	1008 hrs	0/66
TC + PC	JESD22-A104	Ta= -40°C to +100°C	300 cyc	0/66
THB + PC	JESD22-A101	Ta=85°C / 85% RH, biased	1008 hrs	0/66
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 4 @ 260°C	-	0/132
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-	0/66

**最終製品 / プロセス変更通知**

文書番号# : FPCN23072X

発行日: 12 Feb 2020

電気的特性の要約:

電気的特性への影響はありません。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
QRE1113GR	QRE1113GR